

本校醫學工程學院研究團隊，榮獲 2025 智慧創新大賞銅牌獎

經濟部為推動 AI 應用技術發展與人才培育，首次舉辦「2025 智慧創新大賞 Best AI Awards」。這項臺灣規模最大、獎項最高的 AI 競賽，吸引了全球 36 個國家、1,253 組隊伍參賽，最終僅有 93 個專案脫穎而出。臺北醫學大學醫學工程學院的研究團隊表現亮眼，榮獲 IC 設計國際組銅牌獎及新臺幣 50 萬元獎金。

獲獎團隊由生醫光機電研究所所長楊自森教授與張承仁教授共同指導，帶領來自孟加拉的 ASADUZZAMAN、越南的 NGUYEN DINH HIEN 與 NGUYEN



LE THANH HANG，以及印度的 AJITESH DHAL 等國際學生參賽。團隊以專案「Smart Wound Care for Diabetic Foot Ulcers Using AI and Biosensor」榮獲 IC 設計國際組銅牌獎及新臺幣 50 萬元獎金。

【左圖：頒獎典禮於 2025 年 5 月 3 日在世貿一館舉行，醫工學院團隊榮獲銅牌獎及新臺幣 50 萬元獎金】

此獲獎專案專為糖尿病足部潰瘍（Diabetic Foot Ulcers, DFU）患者設計，整合了 AI 傷口影像分析與高靈敏度生醫感測晶片，開發出具備即時監控功能的智慧傷口照護平臺。其核心技術為立體離子感測場效電晶體生物晶片，能夠從微量血液中快速分析糖化血色素與發炎指標等生化標誌，大幅提升檢測效率。

此外，使用者可透過智慧型手機拍攝傷口影像，AI 模型將即時分析傷口變化、預測惡化風險，並透過數位儀表板與醫療端即時連線，提供居家與臨床之間無縫整合的照護方案。這項創新不僅提升了糖尿病足部潰瘍的照護品質與效率，更展現了臺北醫學大學在智慧醫療領域的進展，以及培育跨國 AI 專業人才的成效。（文/醫學工程學院）【下圖：本校獲獎團隊合影，團隊成員左起 AJITESH



DHAL、NGUYEN LE THANH HANG、楊自森所長、張承仁教授、ASADUZZAMAN、NGUYEN DINH HIEN 以及 BASHIR DANMAHAWAYI ZUBAIRU】